

## IC-Buchsenkontakte einzeln, auf Kunststoffträger, RM 2,54mm Single IC Female Contacts on Plastic Holder, 2.54mm Pitch

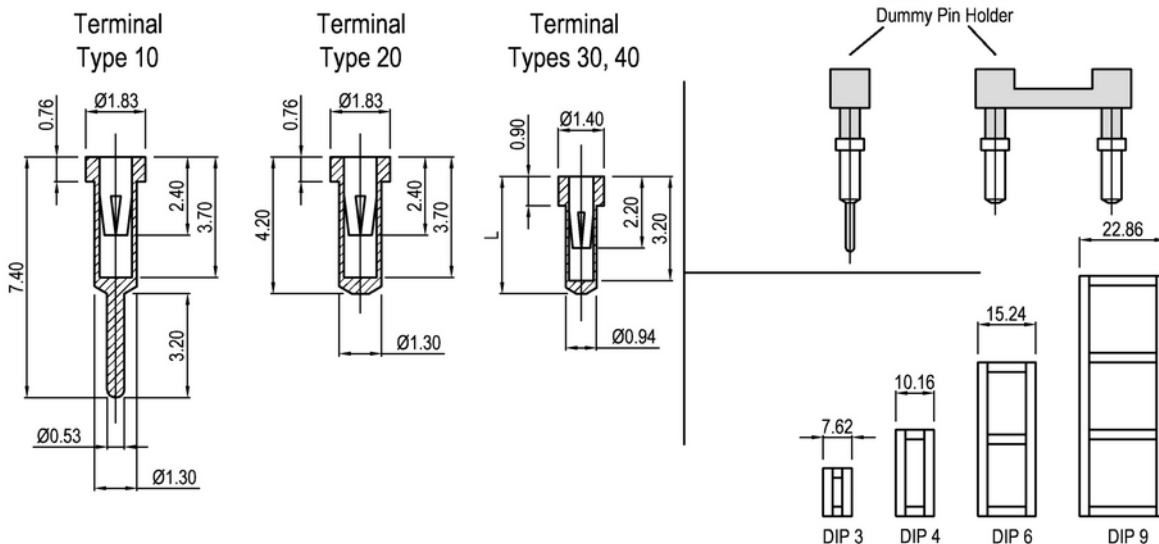
### Technische Daten / Technical Data

Gehäuse/Abdeckung/Hebel <i>Case/Cover/Actuator</i>	Thermoplastischer Kunststoff, nach UL94 V-0 <i>Thermoplastic, rated UL94 V-0</i>
Kontaktmaterial	Hülse: Messing gedreht Feder: 4-Lamellen-Clip, Beryllium-Kupfer <i>Sleeve: screw machined brass</i> <i>Clip: 4-Finger-Clip, Beryllium-Copper</i>
Contact Material	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni (2 ... 3µm) IEC 60512-12A
Kontaktoberfläche <i>Contact Surface</i>	IEC 60512-12A
Lötbarkeit <i>Solderability</i>	< 10mΩ <i>Contact Resistance</i>
Durchgangswiderstand <i>Contact Resistance</i>	> 1000MΩ <i>Insulation Resistance</i>
Isolationswiderstand <i>Insulation Resistance</i>	1kV <sub>RMS</sub> <i>Test Voltage</i>
Spannungsfestigkeit <i>Test Voltage</i>	100V <sub>RMS</sub> / 150V <sub>DC</sub> <i>Voltage Rating</i>
Nennspannung <i>Voltage Rating</i>	100V <sub>RMS</sub> / 150V <sub>DC</sub>
Nennstrom <i>Current Rating</i>	1A
Temperaturbereich <i>Temperature Range</i>	-55°C ... +125°C
Verarbeitung <i>Processing</i>	Wellen- oder Reflow-Lötverfahren <i>Wave or reflow soldering</i>



© W+P PRODUCTS

Für Rundstifte Ø0,40-0,56mm  
oder Vierkantstifte 0,25x0,45mm.  
For Ø0.40-0.56mm round pins  
or 0.25x0.45mm rectangular pins.



Series	Contacts*	DIP Spacing*	Terminals*	Sleeve Plating	Clip Plating*
<b>325</b>	<b>14</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>50</b>	<b>00</b>
325 Träger IC-Fassungen <i>Carrier IC-Sockets</i>	06/08/10/ 12/14/16 ==>> 18/20/22/ 24/28/32 ==>> 10/24/28/ 32/36/40/ 42/48/50/52=> 50/52/64 ==>>	3 7,62mm 4 10,16mm 6 15,24mm 9 22,86mm	10 Mit Einlötlstift <i>With solder tail</i> 20 Ohne Einlötlstift <i>W/o solder tail</i>	50 Verzinnt (Standard) <i>Tin plated (Standard)</i>	00 Vergoldet <i>Gold plated</i> 10 Vergoldet 0,25µm <i>0.25µm gold plated</i> 30 Vergoldet 0,75µm <i>0.75µm gold plated</i>

Series	Contacts*	Rows	Terminals*	Sleeve Plating	Clip Plating*
<b>325</b>	<b>18</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>50</b>	<b>00</b>
325 Träger IC-Leisten <i>Carrier IC-Headers</i>	01-64 Einreihig <i>Single row</i>	1 Einreihig <i>Single row</i>	10 Mit Einlötlstift <i>With solder tail</i> 20 Ohne Einlötlstift <i>W/o solder tail</i> 30 L=3,7mm <i>L=3.7mm</i> 40 L=6,3mm <i>L=6.3mm</i>	50 Verzinnt (Standard) <i>Tin plated (Standard)</i>	00 Vergoldet <i>Gold plated</i> 10 Vergoldet 0,25µm <i>0.25µm gold plated</i> 30 Vergoldet 0,75µm <i>0.75µm gold plated</i>

\* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -  
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.  
\* This is an **order example** -  
please replace by your specifications.

TEL +49 5223 98507-0  
FAX +49 5223 98507-50

**W+P PRODUCTS**

E-MAIL sales@wpro.com  
WEBSITE www.wpro.com

# Informationen zum Reflow-Lötverfahren

## Reflow Soldering Information

### Reflow-Lötempfehlung

#### Reflow Soldering Recommendation

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum $T_{Smin}$	150°C
Temperatur Maximum $T_{Smax}$	200°C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	60-180s
Temperatur Lötbereich $T_L$	217°C
Verweildauer oberhalb $T_L$	60-180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3°C / s
Höchsttemperatur $T_P$	260°C ±5
Dauer Höchsttemperatur	20-40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6°C / s
Dauer 25°C - Höchsttemperatur $T_P$	Max. 8 min

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature $T_{Smin}$	150°C
Maximum Temperatur $T_{Smax}$	200°C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	60-180s
Soldering Range Temperature $T_L$	217°C
Duration above $T_L$	60-180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3°C / s
Peak Temperature $T_P$	260°C ±5
Duration Peak Temperature	20-40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6°C / s
Duration 25°C - Peak Temp. $T_P$	Max. 8min



## Empfehlungen für das Wellenlötverfahren

### Recommendations for Wave Soldering

Die Bauteile sollten bei einer Lötbadtemperatur von 260°C in max. 5 Sekunden verlötet werden.  
*Items should be soldered at a solder temperature of 260°C in 5 seconds max.*

Empfohlenes Wellenlötprofil:

*Recommended wave soldering profile:*

